



## 機能性と安全性を保持しながら、様々な色調に対応する フレキシブル基板向け低反発ソルダーレジスト

新製品  
new product

Low spring-back, halogen-free and colorful solder resist for FPC

# PAF-300-14 SERIES

項目 Items	評価条件 Test condition	PAF-300-14A	従来品 Conventional	項目 Items	評価条件 Test condition	PAF-300-14A	従来品 Conventional
感度 Sensitivity	コダック ステップタブレット 14段 Kodak steptablet 14 steps 200mJ/cm <sup>2</sup>	8段 8 steps	7段 7 steps	耐溶剤性 Solvent resistance	IPA-30min ゼロハンテーパーピーリング IPA-30min tape peeling test	剥離無し no peel-off	剥離無し no peel-off
折曲性 Flexibility	はぜ折り(ポリイミド 25μm上) Bending 180degree (on Polyimide 25μm)	20回 20 times	20回 20 times	解像度 Resolution	ポリイミド上 on polyimide (25μm)  Cu上 on Cu of two layer CCL (Cu : 12, Pl : 25)	50μm	50μm
反り性 Warpage	サイズ50×50mm (ポリイミド 25μm上) Size 50×50 (on Polyimide 25μm)	1~2mm	1~2mm	HHBT	85°C-85%RH	1000時間OK 1000h OK	1000時間OK 1000h OK
塗膜硬度 Film hardness	JIS K5400	2H	3H	UL	UL-94	VTM-0	VTM-0
密着性 Adhesion Cross cut test	ポリイミド上 on polyimide  Cu上 on copper	100/100	100/100	物性値 Physical values	Tg(TMA)	50~55°C	50~55°C
耐酸性 Acid resistance	10%HCl-15min ゼロハンテーパーピーリング 10%HCl-15min tape peeling test	剥離無し no peel-off	剥離無し no peel-off	破断強度 Breaking strength		12~17MPa	15~20MPa
				破断伸び elongation		60~70%	25~45%
				弾性率 elastic modulus		0.4~0.5GPa	1.0~1.1GPa



## フレキシブル基板に適した 黒色吸収材

Black absorbing material for FPC

# APB-300-11

写真現像型 Photo-imageable : APB-300-11

### 特長 Features

- FPC基板への密着性が良い Excellent adhesion to FPC
- はぜ折り性に優れる Excellent bending
- 解像度に優れる Excellent Resolution
- ハロゲンフリー Halogen Free
- 難燃性 Flame resistance

評価項目 Test items	評価条件 Test condition	APB-300-11
外観 Appearance	目視/グロス値(60°) Gloss value 60°	黒色マット/15~25 Black Matt/15~25
塗膜硬度 Film hardness	鉛筆硬度試験 Pencil hardness test	3H
密着性 Adhesion 銅/ポリイミド Cu/Polyimide	基盤目試験 Cross-cut test	100/100
折曲性 Flexibility	はぜ折り300g荷重 180 degree bending at 300g load	1回 1time
UL	UL-94	VTM-0